

平成19年9月期 中間決算説明会



Automobile Industry



IT Industry

May 15,2007

1/37



平成19年9月期中間
業績結果について



2/37

平成19年9月期中間決算概要-①



連結損益計算書

(単位 百万円)

	19/9期中間	18/9期中間	増減額	増減率
売上高	20,980	19,902	+1,077	+5.4%
売上総利益	5,833	6,092	△258	△4.2%
売上総利益率	27.8%	30.6%		△2.8P
販管費	3,364	3,388	△23	△0.7%
販管費率	16.0%	17.0%		△1.0P
営業利益	2,468	2,703	△234	△8.7%
営業利益率	11.8%	13.6%		△1.8P
経常利益	2,668	2,956	△287	△9.7%
経常利益率	12.7%	14.8%		△2.1P
当期純利益	1,666	2,068	△401	△19.4%
当期純利益率	8.0%	10.4%		△2.4P

増収減益

□ 売上 各セグメントで増加

抵抗 → +372百万円(18/9中比+3.9%)

平面 → +749百万円(18/9中比+7.4%)

□ 粗利 抵抗減益、平面増益

抵抗 → △355百万円(18/9中比△11.9%)

平面 → +117百万円(18/9中比 3.8%)

<概要>

抵抗・高水準による売上を維持
・原材料高などによる収益減少

平面・シリコンウェーハ各社の積極的な
設備投資による受注増加
・原材料高あるものの、ボリューム増加
による収益確保



3/37

平成19年9月期中間決算概要-②



連結損益計算書

■セグメント別損益

(単位 百万円)

	抵抗溶接	増減額	レーザー	増減額	平面研磨	増減額	合計	増減額
売上高	9,980	+372	145	△44	10,855	+749	20,980	+1,077
売上総利益	2,636	△355	17	△20	3,179	+117	5,833	△258
売上総利益率	26.4%	△4.7P	12.3%	△7.9P	29.3%	△1.0P	27.8%	△2.8P
販管費	1,690	△68	69	+3	1,605	+39	3,364	△23
販管費率	16.9%	△1.4P	47.6%	+13.1P	14.8%	△0.7P	16.0%	△1.0P
営業利益	945	△289	△51	△24	1,574	+78	2,468	△234
営業利益率	9.5%	△3.4P	△35.3%	△21.0P	14.5%	△0.3P	11.8%	△1.8P



* 上記は参考数値であり正式な開示数値ではありません

4/37

平成19年9月期中間決算概要-③



連結損益計算書

販売費及び一般管理費

(単位: 百万円)

	19/9期中間		18/9期中間		増減
	金額	売上比	金額	売上比	金額
人件費	1,721	8.2%	1,694	8.5%	+27
減価償却費	203	1.0%	190	1.0%	+13
運送費	327	1.6%	277	1.4%	+50
旅費交通費	260	1.2%	192	1.0%	+68
研究開発費	73	0.3%	145	0.7%	△72
その他	778	3.7%	888	4.4%	△110
合計	3,364	16.0%	3,388	17.0%	△23



5/37

平成19年9月期中間決算概要-④



営業外損益

有価証券売却益 → 75百万円
為替差益 → 30百万円

法人税等

税効果適用後の実効税率 → 35.9% (18/9中間 27.6%)



6/37

平成19年9月期中間決算概要-⑤



連結貸借対照表

(単位: 百万円)

資産	19/9期中間		18/9期		増減	負債純資産	19/9期中間		18/9期		増減
	金額	構成比	金額	構成比			金額	構成比	金額	構成比	
流動資産	28,510	70.3%	24,972	67.2%	+3,537	流動負債	15,875	39.2%	13,669	36.8%	+2,205
有形固定資産	9,046	22.3%	8,941	24.1%	+104	固定負債	1,865	4.6%	1,992	5.3%	△127
無形固定資産	247	0.6%	226	0.6%	+21	(有利子負債)	(5,798)	(14.3%)	(4,334)	(11.7%)	(+1,463)
投資等	2,729	6.8%	3,025	8.1%	△296	純資産	22,792	56.2%	21,503	57.9%	+1,288
合計	40,533	100.0%	37,166	100.0%	+3,367	合計	40,533	100.0%	37,166	100.0%	+3,367

主な増減

現金及び預金	→	782百万円 増 (19/9中	5,425百万円	18/9期	4,642百万円)
売掛債権	→	1,384百万円 増 (19/9中	12,585百万円	18/9期	11,200百万円)
たな卸資産	→	1,370百万円 増 (19/9中	8,537百万円	18/9期	7,167百万円)
買掛債務	→	985百万円 増 (19/9中	7,406百万円	18/9期	6,420百万円)



7/37



通期の見通しと グループの展望



8/37

連結会社の系統図



OBARA株式会社



抵抗溶接

レーザー溶接



平面研磨装置

スピードファム株式会社

OBARA CORP. USA
 小原（南京）機電有限公司
 小原（上海）有限公司
 韓国小原株式会社
 OBARA (THAILAND) CO., LTD.
 OBARA (MALAYSIA) SDN. BHD.
 洋光産業株式会社
 OBARA MEXICO, S. DE R. L. DE C. V.
 OBARA AUSTRALIA PTY. LTD.
 OBARA INDIA PRIVATE LTD.

佐久精機株式会社
 S/Fクリーンシステム株式会社
 SPEEDFAM台湾
 SPEEDFAMインド
 SPEEDFAM上海
 SPEEDFAM USA
 SPEEDFAM ベルギー
 SPEEDFAM (BVI) LTD.



9/37

平成19年9月期業績予想(通期連結)



(単位 百万円)

	19/9期予想	18/9期実績	増減額	増減率
売上高	42,300	39,748	+2,551	+6.4%
売上総利益	11,800	12,119	△319	△2.6%
売上総利益率	27.9%	30.5%		△2.6P
販管費	6,850	7,276	△426	△5.9%
販管費率	16.2%	18.3%		△2.1P
営業利益	4,950	4,842	+107	+2.2%
営業利益率	11.7%	12.2%		△0.5P
経常利益	5,250	5,202	+47	+0.9%
経常利益率	12.4%	13.1%		△0.7P
当期純利益	3,250	3,633	△383	△10.5%
当期純利益率	7.7%	9.2%		△1.5P



*平成19年5月11日付け、修正済み数値

10/37

平成19年9月期予想(上・下半期)

(単位 百万円)

	19/9期 上半期実績	前同期比	19/9期 下半期予想	前同期比
売上高	20,980	+1,077	21,319	+1,473
売上総利益	5,833	△258	5,966	△60
売上総利益率	27.8%	△2.8P	28.0%	△2.4P
販管費	3,364	△23	3,485	△402
販管費率	16.0%	△1.0P	16.3%	△3.2P
営業利益	2,468	△234	2,481	+342
営業利益率	11.8%	△1.8P	11.6%	+0.9P
経常利益	2,668	△287	2,581	+334
経常利益率	12.7%	△2.0P	12.1%	+0.8P
当期純利益	1,666	△401	1,583	+18
当期純利益率	8.0%	△2.3P	7.4%	△0.5P

平成19年9月期業績予想(セグメント別)

(単位 百万円)

	抵抗溶接	前同期比	レーザー	前同期比	平面研磨	前同期比	合計	前同期比
売上高	19,300	+262	500	+25	22,500	+2,262	42,300	+2,551
売上総利益	4,970	△583	130	△2	6,700	+266	11,800	△319
売上総利益率	25.8%	△3.4P	26.0%	△1.9P	29.8%	△2.0P	27.9%	△2.8P
販管費	3,400	△285	120	△9	3,330	△132	6,850	△426
販管費率	17.6%	△1.7P	24.0%	△3.3P	14.8%	△2.3P	16.2%	△2.1P
営業利益	1,570	△298	10	+7	3,370	+398	4,950	+107
営業利益率	8.1%	△1.7P	2.0%	+1.4P	15.0%	+0.3P	11.7%	△0.5P

* 上記は参考数値であり正式な開示数値ではありません

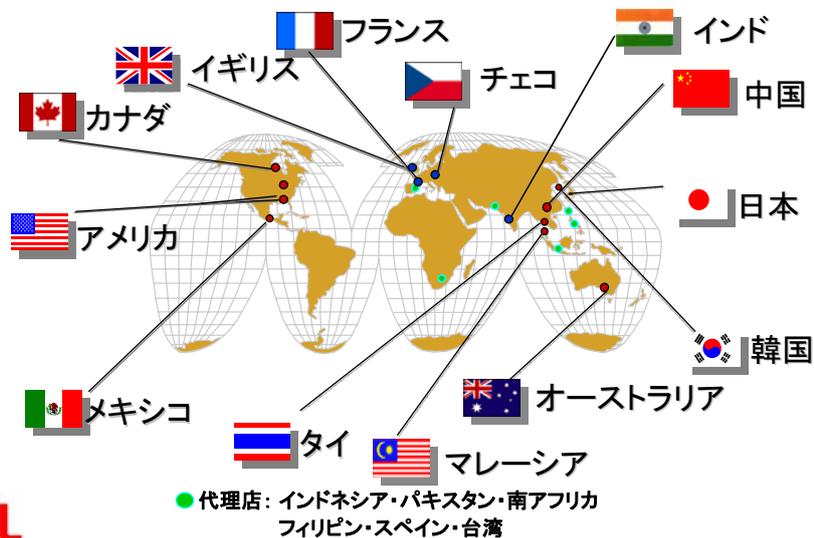
主な項目の実績と予算

	(前期実績)	(今期予算)
◆設備投資	1,972百万円 →	1,800百万円
◆減価償却費	1,017百万円 →	1,050百万円
◆研究開発費	567百万円 →	570百万円
◆為替想定レート		
	\$=116円(1円の変動で約15百万円の経常利益が変動)	

抵抗溶接事業の概況

< 抵抗溶接連結 >

グローバル拠点網



15/37

< 抵抗溶接連結 >

抵抗溶接事業の概況

- 自動車メーカーの設備投資が一部調整局面
- 主要原材料である銅価格の高止まりに伴う売上原価上昇などの影響に伴い減益
- グローバル体制推進によるお客様へのサポート体制を強化



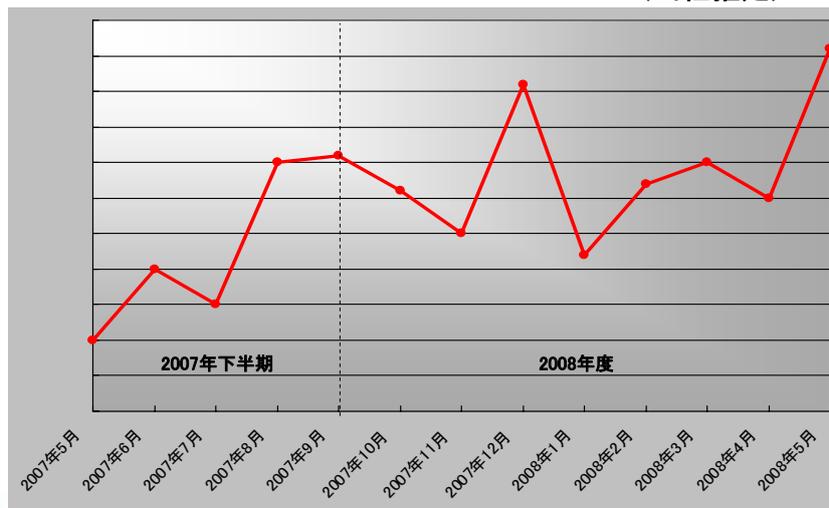
16/37

主要原材料、銅の値動き



今後の溶接関連の設備需要

(当社推定)



国内自動車メーカー様の溶接関連(一部)



18/37

<抵抗溶接連結>

抵抗溶接事業 平成19年9月期業績予想

(単位 百万円)

	19/9期 上半期実績	前同期比	19/9期 下半期予想	前同期比	19/9期 通期予想	前同期比
売上高	9,980	+372	9,319	△110	19,300	+262
売上総利益	2,636	△355	2,333	△227	4,970	△583
売上総利益率	26.4%	△4.7P	25.0%	△2.1P	25.8%	△3.4P
販管費	1,690	△66	1,709	△218	3,400	△285
販管費率	16.9%	△1.4P	18.3%	△2.1P	17.6%	△1.7P
営業利益	945	△289	624	△9	1,570	△298
営業利益率	9.5%	△3.4P	6.7%	△0.0P	8.1%	△1.7P

* 上記は参考数値であり正式な開示数値ではありません

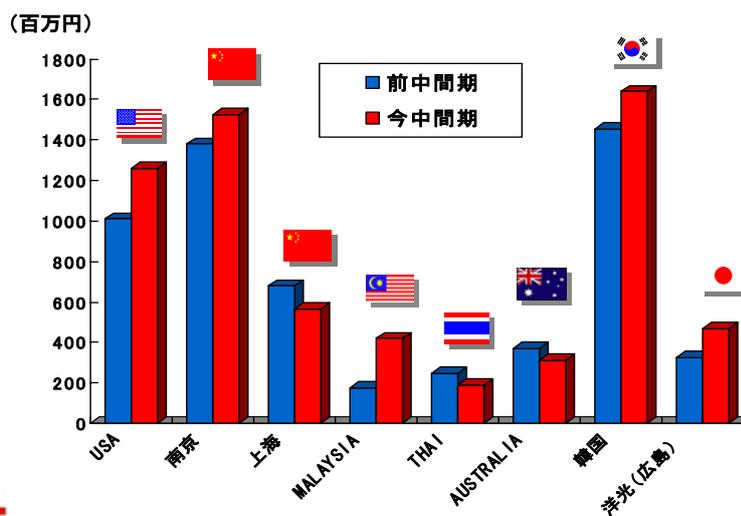


19/37

<抵抗溶接連結>

子会社別の売上高実績

(中間期)

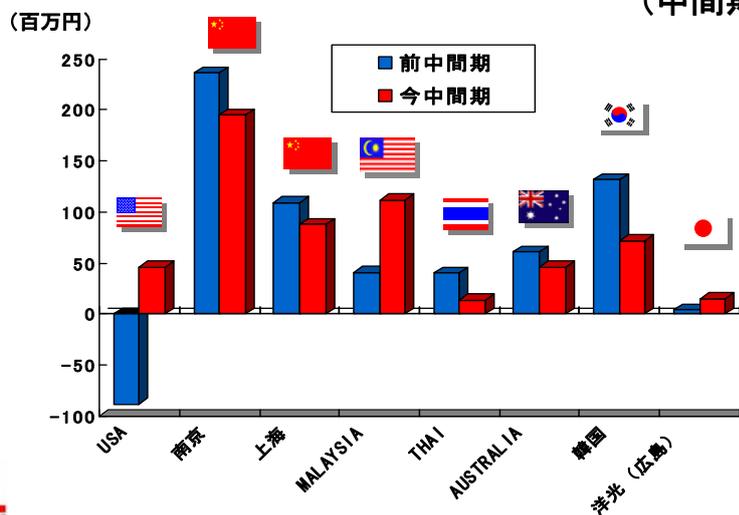


20/37

<抵抗溶接連結>

子会社別の当期純利益実績

(中間期)



21/37

溶接グループとして

- ▶ OBARA THAILAND 新工場建設(能力増強)
- ▶ OBARA KOREA 新工場建設(能力増強・効率化)
- ▶ レーザー YAGレーザーの新機種販売開始(販売強化)
- ▶ 消耗品の積極販売→お客様の生産量アップに対応し、大量且つ即納体制強化により電極等を拡販(販売強化)



22/37

<抵抗溶接連結>

Topics①

タイの現地法人、新工場準備開始 (生産能力拡大へ)



既存工場

工場の概要

土地 5,250 m²

建物 2,400 m²

日程(予定)

着工 2007/6

完成 2008年上期

稼動 2008年下期

計画

2011年に売上60%増加

23/37

<抵抗溶接連結>

Topics②

韓国の現地法人、新工場準備開始 (工場集約・生産能力拡大へ)



既存工場
(3ヶ所)

新工場
莞安(バラン)

工場の概要

土地 12,850 m²

建物 15,420 m²

日程(予定)

着工 2007/6

完成 2007/11

稼動 2008年下期

効果(現地法人、現状比)

能力 30%増加

コスト 20%削減

24/37

YAGレーザー新機種発売開始

商品名

OLY-1000

用途

電子部品、機械部品、自動車部品などの溶接

特色

お客様からの要望の高かった80W、150Wの中間に位置し、高出力且つ高繰返しを実現した商品

今後

商品ラインナップの見劣りを順次改善し、販売強化に努める。



平面研磨装置関連事業の概況





平面研磨事業の概況

世界的に、エレクトロニクス製品市場が好調

- ▶ Siウェーハ顧客の旺盛な設備投資ニーズに高精度研磨装置を積極販売
- ▶ ハードディスクドライブの市場拡大により装置販売が伸張

27/37



平面研磨事業 平成19年9月期業績予想

(単位 百万円)

	19/9期 上半期実績	前同期比	19/9期 下半期予想	前同期比	19/9期 通期予想	前同期比
売上高	10,855	+749	11,644	+1,512	22,500	+2,262
売上総利益	3,179	+117	3,520	+148	6,700	+266
売上総利益率	29.3%	△1.0P	30.2%	△3.0P	29.8%	△2.0P
販管費	1,605	+39	1,724	△171	3,330	△132
販管費率	14.8%	△0.7P	14.8%	△3.9P	14.8%	△2.3P
営業利益	1,574	+78	1,795	+319	3,370	+398
営業利益率	14.5%	△0.3P	15.4%	+0.9P	15.0%	+0.3P

* 上記は参考数値であり、正式な開示数値ではありません

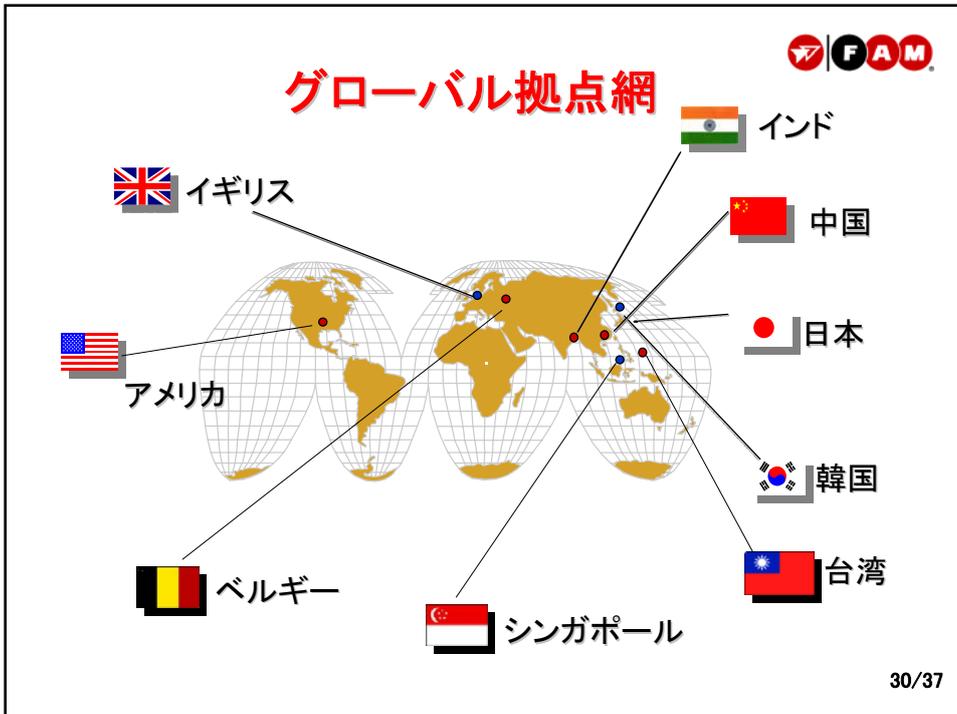
28/37



商品群

- ▶ 片面研磨装置、両面研磨装置
- ▶ 端面研磨装置（エッジポリッシャー）
- ▶ 洗浄装置
- ▶ ドライエッチャー装置（DCP）
- ▶ 消耗副資材（定盤・研磨剤・研磨布など）

29/37

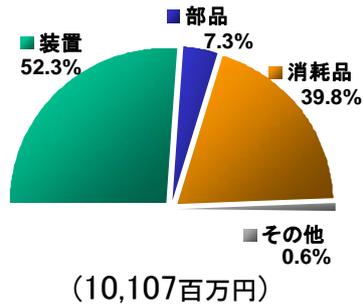


30/37

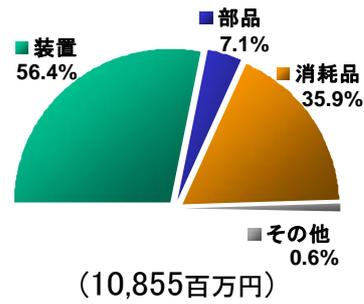
セグメント情報

— 商品別売上構成比 —

18年9月期中間



19年9月期中間

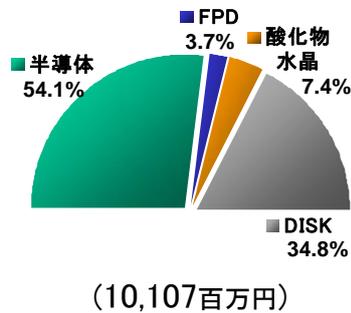


31/37

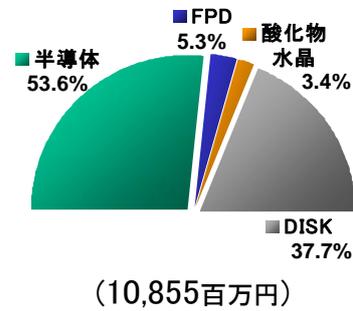
セグメント情報

— アプリケーション別売上構成比 —

18年9月期中間



19年9月期中間



32/37



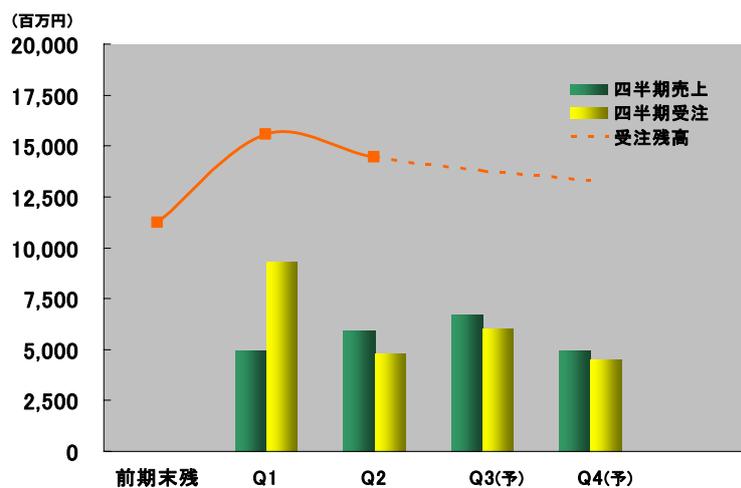
当中間期の傾注項目の結果

- ▶ 最先端 Si ウェーハ向け両面研磨装置の展開
 売上計上16.4億円と受注残高72.2億円
- ▶ ハードディスク向け装置の拡販
 売上計上25.8億円と受注残高27.5億円
- ▶ 半導体デバイス向けエッジポリシヤの提案
 売上台数 1台と受注残数 3台

33/37



受注残高の推移予測



34/37



SPEEDFAM グループとして

- ▶ Siウエーハ向け研磨装置の増産体制
切迫した装置需要へ追加的な佐久工場増床
19年7月竣工予定、設備投資額 3億円
当期末、製造能力を30%増へ
(年間ベース55億円から、70億円水準に)
- ▶ 高精度化ニーズへの先取り対応
装置及び消耗品の改善改良を推進

35/37

OBARAグループのVISION

■ *Niche市場において*
世界一の
企業集団にする



36/37

ご静聴ありがとうございました



<http://www.obara.co.jp>